

8/25

宽能带半导体MA/FA/FT整合测试方案(4)

Integrated WBG Semiconductor Test Solutions

近年来5G通讯、电动车市场崛起，宽能带半导体(WBG)材料如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率组件崭露头角，于车用市场渗透率持续攀升。然而电动车安全续航力与节能效率引发关注，车载电池是否能承受大容量及高电压、充放电时高温耐受性、是否会因高温引发风险，不同质量的控制器搭配电池也会在续航能力上显示出差别，故芯片结构坚固及热稳定性佳尤其至关重要。

筑波科技与国际大厂指定的Teradyne ETS、Tektronix产品线合作，创造前所未有的测试平台扩展能力，提供一站式的半导体MA/CP/FT测试服务，拥有高精度、高稳定度、耐高温、高电压(>1200V)、高电流(>100A)特性，增强高功率半导体产业的研发质量与生产效率的ROI，提供双赢的测试设备系统软/硬整合方案服务。

筑波科技拥有WBG材料分析与电源管理IC/module动态测试解决方案，在异质材料界面、Wafer、Epi的材料分析MA与故障瑕疵分析FA，封装后FT整合测试质量与生产效率提升有丰富经验，半导体EC工程中心能实时在地服务，符合客户全方位测试需求，本次研讨会将分享测试技术实务经验。

我们邀请您与筑波科技专业团队就相关议题和技术交流！欢迎宽能带半导体及3DIC产业领域的厂商先进主管报名参加。

PM 1:00~1:30	Registration 报到登记	
PM 1:30~1:40	Welcome 致欢迎词	Richard Hsieh, APAC Sales VP, Teradyne 谢顺富, Teradyne 亚太区业务副总裁
PM 1:40~2:10	WBG Market Trend and Teradyne Eagle System Introduction Practice WBG 市场趋势及Eagle 系统实务介绍	Steve Hsu, President ACE 许深福, 筑波科技 董事长 Eric Syu, BD Manager ACE 许振扬, 筑波科技 商务开发经理
PM 2:10~2:40	GaN HEMT with High Gate Stem and Thick Copper Metallization to Improve RF Performance	Edward-Yi Chang, Ph.D.& Professor, NYCU 张翼院长 国立阳明交通大学, 国际半导体产业学院
PM 2:40~3:10	WBG功率半导体之关键特性分析与萃取	William Wu, Sr. Account Manager Tektronix 吴道屏, 太克科技 资深业务经理
PM 3:10~3:40	Tea Break 中场休息&方案展示	
PM 3:40~4:00	Brief WBG Integrated MA/FA/FT Test Solutions 简述化合物半导体MA/FA/FT 整合测试方案	Walter Chen, GM ACE 陈文豪, 筑波科技 总经理
Workshop Group		
PM 4:00~4:10	A: Eagle System Introduction and GaN DUT with Socket Test (Eagle 系统展示及GaN 实测)	Teradyne/ACE
PM 4:10~4:20	B: 3DIC Advanced Package Failure Analysis (FA 展示介绍)	Teradyne/ACE
PM 4:20~4:30	C: SiC/GaN Wafer MA Test Solution (Wafer 材料表面及电气特性实测)	Teradyne/ACE
PM 4:30~4:40	D: Flexible Semiconductor Equipment Methodology (半导体设备弹性服务新思维)	Teradyne/ACE
PM 4:40~5:00	Q&A 会后讨论	

活动日期: 2022年08月25日(四) PM1:00 – PM5:00

活动地点: 线上直播 (VIP邀请 ONLY)

报名方式: Ken Lin: 15150183920 (华东/华北)
Fred Huang: 18666826750(华南/华西)

在线报名: http://register.acesolution.com.tw/2022_ACE_Teradyne_ETS_0825



手机扫码报名

Tektronix® TERADYNE



筑波科技股份有限公司
ACE.Solution Co.,Ltd.